

Ubicación de componentes	Comentarios	Cumple/No cumple/No aplica
1. Orientación consistente de componentes SMD	(pseudo consistente)	Cumple
2. Espacio para herramientas de retrabajo		-
3. Verificar componentes polarizados		-
4. Utilizar grilla de 50 mil para componentes THT		-
5. Verificar orientación de todos los conectores		Cumple
6. Verificar espacio mínimo entre cuerpo de componentes		Cumple
7. Capacitores de desacople (bypass) cerca de pines de alimentación de los IC		No cumple
8. Verificar terminadores en serie cercanos a la fuente		-
9. Drivers I/O cercanos a donde las señales abandonan el PCB	Peripheral pin header podría estar más en el borde	Cumple
10. Torretas a GND, pistas de alimentación y test points, todos etiquetados.	Solo test points	No cumple
11. Filtros EMI y RFI lo más cerca posible a puntos de entrada y salida en áreas blindadas.		No aplica
12. Ubicar componentes de manera tal que un rework o reparación de un componente no requiera remover otros.		Probablemente no aplica
13. Los potenciómetros deberían incrementar la cantidad controlada en sentido de las agujas del reloj.		No aplica
14. Verificar si los orificios de montaje deben estar aislados eléctricamente o no.		Chequear
15. Verificar distancia de seguridad de los orificios de montaje hacia otros componentes.		Cumple
16. Verificar factor de forma de los pads SMD.		Cumple creo.
17. Fiduciales para ensamble automático.		Cumple
18. Distancia de seguridad suficiente para ICs con zócalo.		No aplica
Ruteo/pistas	Comentarios	Cumple/No cumple/No aplica
1. Comunes digitales y analógicos unidos en un solo punto.	Varios puntos de gnd y cgnd	No cumple
2. Verificar pistas debajo de componentes ruidosos o sensibles.		Cumple creo.
3. No ubicar vías debajo de resistores de metalfilm u otros componentes con aislación pobre.		Cumple
4. Verificar pistas susceptibles a puentes de soldadura.		Chequear
5. Verificar pistas sin conexión en un extremo, a menos que sea a propósito.		Cumple
6. Asegurar que el CAD unifica o no señales Vcc/Vdd y Vss/GND según lo requiera el diseño.		Cumple
7. Utilizar múltiples vías en pistas de alta corriente y/o baja impedancia.		Cumple creo.
8. Observar keepout de componentes y pistas.		Cumple
9. Utilizar planos de GND donde sea posible.		Cumple
Dimensiones	Comentarios	Cumple/No cumple/No aplica
1. Diámetro de orificios debe considerar el metalizado.		Cumple
2. Diámetro de orificios más grande que el diámetro de pata al menos en 10 mils.		Cumple creo.
3. Ancho de texto en silkscreen 0.25mm o más.	Min 0.5	Cumple
4. Pad al menos 0.4mm más grande que drill.		Cumple
5. Componentes ubicados al menos a 5mm del borde del PCB.		Cumple
6. Test pads ubicados al menos a 5mm del borde del PCB.		Cumple
7. Pistas al menos a 0.5mm del borde del PCB.		Cumple
8. Tolerancia de drills especificada.		Cumple creo.
9. Tolerancia de máscara antisoldante especificada.		Chequear
10. Tolerancia de pistas especificada.		Cumple creo.
11. Tolerancia de serigrafía especificada.		Chequear
12. Ancho de pista suficiente para la corriente conducida.		Cumple creo.
13. Distancia suficiente entre pistas de alto voltaje.		No aplica
Serigrafía (silkscreen)	Comentarios	Cumple/No cumple/No aplica
1. Evitar serigrafía sobre vías sin máscara u orificios.		No cumple
2. Todos los textos y leyendas legibles en una o dos direcciones.		Cumple creo.
3. Logo de la compañía en serigrafía.		Cumple
4. Logo de la compañía en cobre.		No cumple
5. Nota de copyright en PCB.		No cumple
6. Fecha en PCB.		No cumple
7. Número de parte en PCB.		Cumple
8. Número de parte de montaje en PCB.		No cumple
9. Revisión del PCB en serigrafía.		No cumple
10. Espacio para revisión de montaje en serigrafía.		No cumple
11. Espacio para número de serie en serigrafía.		No cumple
12. Ubicar todo el texto de la serigrafía de manera tal que sea legible cuando los componentes están montados.	Solo labels de	No cumple
13. Todos los ICs deben tener el pin 1 debidamente marcado y visible con el IC instalado.		Cumple creo.
14. ICs de muchos pines deberían tener los pines extremos numerados para facilitar su identificación.		Cumple.
15. Marcas cada 5 o 10 pines en ICs o conectores de muchos pines para facilitar su identificación.		No cumple
Otros	Comentarios	Cumple/No cumple/No aplica
1. Utilizar DRC y ERC habilitados en el CAD.	No estoy 100% seguro.	Cumple
2. Tomar las precauciones necesarias en circuitos de alta frecuencia.		No aplica
3. Colocar conectores y pines extra en prototipos para pruebas, por si es necesario.		Cumple
4. Verificar dimensiones y formas de orificios en conectores raros (rectangulares, ovalados).		Cumple
5. Verificar si la máscara antisoldante cubre o no cubre las vías.		Chequear
6. No rutear ángulos agudos.		Cumple
7. Verificar profundidad de la máscara antisoldante.		Chequear
8. Verificar el netlist manualmente o por inspección visual.		Cumple
9. Verificar si existen conexiones de un único pin y si son intencionales.		Cumple
10. Verificar si el origen de orificios es un pad de referencia.		Cumple
11. Anotar en layer auxiliar ancho del PCB, material y peso del cobre.		No cumple
12. Utilizar aislamiento térmico (thermal relief) en capas internas de distribución de alimentación.		Cumple
13. Verificar que las aperturas para pasta de estaño sean del tamaño adecuado.		Chequear
14. Verificar si se permiten blind/buried vías en PCB multicapa.		Cumple
15. Definir correctamente el panelizado del PCB.		No cumple
16. Encapsulados metálicos de cristales de alta frecuencia deberían conectarse a GND.		No aplica